

Finitura: questa scheda deve essere placcata in oro a immersione secondo IPC-6012. Spessore deve essere .050uM oltre 3-6uM nichel.

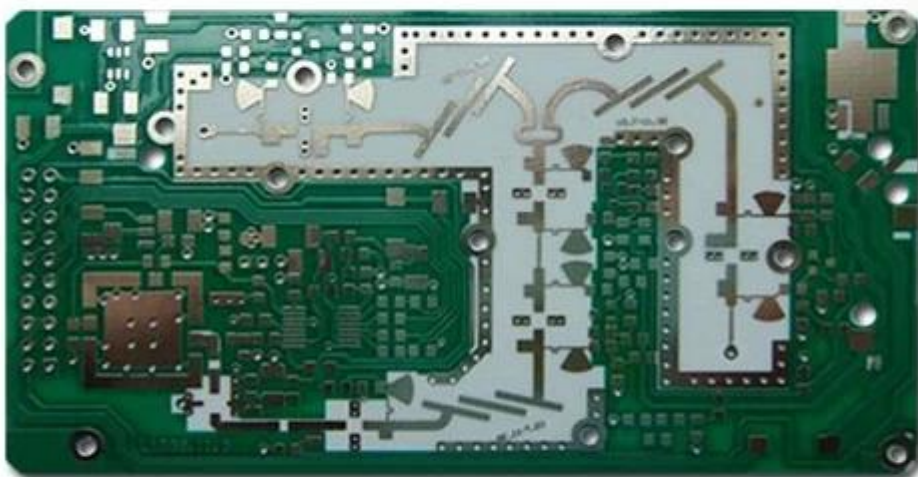
Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	Ilame
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H
L2	91.2163		0.5oz	0.6	
				9.56966	IT180A 2116 RC56% ①
					IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06		0.5oz	0.6	IT180A 0.800mm H/H 41*43
L4	0			9.7	IT180A 2116 RC56% ①
					IT180A 2116 RC56% ②
L5	0		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H 41*43
SOLD	96.96				

O-LEADING
To Be Reliable. To Be Valuable



www.o-leading.com

Più economici produttori di PCB porcellana, Quick Turn PCB stampato circuito di bordo Fornitore